



GW1NZ 系列 FPGA 产品 封装与管脚手册

UG843-1.1,2019-01-10

版权所有©2019 广东高云半导体科技股份有限公司

未经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些档进行适时的更新。

版本信息

日期	版本	说明
2018/10/22	1.0	初始版本。
2019/01/10	1.1	更新 2.6 IO BANK 说明。

目录

目录.....	i
图目录.....	ii
表目录.....	iii
1 关于本手册.....	1
1.1 手册内容.....	1
1.2 适用产品.....	1
1.3 相关文档.....	1
1.4 术语、缩略语.....	2
1.5 技术支持与反馈.....	2
2 概述.....	3
2.1 无铅封装.....	3
2.2 封装和最大用户 I/O 信息.....	4
2.3 电源管脚.....	4
2.4 管脚数目.....	5
2.4.1 GW1NZ-1 器件管脚数目.....	5
2.5 管脚定义说明.....	5
2.6 I/O BANK 说明.....	8
3 管脚分布示意图.....	9
3.1 GW1NZ-1 器件管脚分布示意图.....	9
3.1.1 CS16 管脚分布示意图.....	9
3.1.2 FN32 管脚分布示意图.....	10
4 封装尺寸.....	11
4.1 封装尺寸 CS16 Package Outline (1.8mm x 1.8mm).....	12
4.2 封装尺寸 FN32 Package Outline (4mm x 4mm).....	13

图目录

图 2-1 GW1NZ 系列 FPGA 产品 I/O BANK 整体示意图.....	8
图 3-1 GW1NZ-1 器件 CS16 封装管脚分布示意图（顶视图）	9
图 3-2 GW1NZ-1 器件 FN32 封装管脚分布示意图（顶视图）	10
图 4-1 封装尺寸 CS16	12
图 4-2 封装尺寸 FN32	13

表目录

表 1-1 术语、缩略语	2
表 2-1 封装和最大用户 I/O 信息	4
表 2-2 GW1NZ 电源管脚	4
表 2-3 GW1NZ-1 器件管脚数目列表	5
表 2-4 GW1NZ 列 FPGA 产品管脚定义说明	5
表 3-1 GW1NZ-1 器件 CS16 其他管脚	9
表 3-2 GW1NZ-1 器件 FN32 其他管脚	10

1 关于本手册

1.1 手册内容

GW1NZ 系列 FPGA 产品封装与管脚手册主要包括高云半导体 GW1NZ 系列 FPGA 产品的封装介绍、管脚定义说明、管脚数目列表、管脚分布示意图以及封装尺寸图。

1.2 适用产品

本手册中描述的信息适用于以下产品：

GW1NZ 系列 FPGA 产品：GW1NZ-1。

1.3 相关文档

通过登录高云半导体网站 www.gowinsemi.com.cn 可以下载、查看以下相关文档：

1. GW1NZ 系列 FPGA 产品数据手册
2. GW1NZ 系列 FPGA 产品封装与管脚手册
3. GW1NZ-1 器件 Pinout 手册
4. Gowin FPGA 产品编程配置手册

1.4 术语、缩略语

表 1-1 中列出了本手册中出现的相关术语、缩略语及相关释义。

表 1-1 术语、缩略语

术语、缩略语	全称	含义
FPGA	Field Programmable Gate Array	现场可编程门阵列
FN32	QFN32	QFN32 封装
CS16	WLCSP16	WLCSP36 封装

1.5 技术支持与反馈

高云半导体提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网址：www.gowinsemi.com.cn

E-mail：support@gowinsemi.com

Tel: +86 755 8262 0391

2 概述

高云半导体 GW1NZ 系列 FPGA 产品是高云半导体小蜜蜂® (LittleBee®) 家族 FPGA 第一代零功耗产品，具有零功耗、低成本、瞬时启动、非易失性、高安全性、封装类型丰富、使用方便灵活等特点，可广泛应用于工业控制、通信、消费类、视频监控等领域。

高云半导体提供面向市场自主研发的新一代 FPGA 硬件开发环境，支持 GW1NZ 系列 FPGA 产品，能够完成 FPGA 综合、布局、布线、产生数据流文件及下载等一站式工作。

2.1 无铅封装

GW1NZ 系列 FPGA 产品采用无铅工艺封装，绿色环保，符合欧盟的 RoHS 指令。GW1NZ 系列 FPGA 产品物质成分信息符合 IPC-1752 标准文件。

2.2 封装和最大用户 I/O 信息

表 2-1 封装和最大用户 I/O 信息

封装	间距(mm)	尺寸(mm)	GW1NZ-1
FN32	0.4	4 x 4	25
CS16	0.4	1.8 x 1.8	11

注!

- 本手册中 GW1NZ 系列 FPGA 产品封装命名采用缩写的方式，详细信息请参考 [1.4 术语、缩略语](#)。
- JTAGSEL_N 和 JTAG 管脚是互斥管脚，JTAGSEL_N 引脚和 JTAG 下载的 4 个引脚（TCK、TDI、TDO、TMS）不可同时复用为 I/O，此表格的数据为 JTAG 下载的 4 个引脚复用为 I/O 时的情况。

2.3 电源管脚

表 2-2 GW1NZ 电源管脚

VCC	VCCO0	VCCO1	VCCX
VCCM	VSS		

2.4 管脚数目

2.4.1 GW1NZ-1 器件管脚数目

表 2-3 GW1NZ-1 器件管脚数目列表

管脚类型		GW1NZ-1	
		CS16	FN32
I/O 单端/差分对 ¹	BANK0	7/2	12/5
	BANK1	4/0	13/5
最大用户 I/O 总数 ²		11	25
差分对		2	10
VCCX		1	1
VCCO0		1	1
VCCO1		1	1
VSS		1	2
MODE0		1	0
JTAGSEL_N		0	1
VCC/VCCM ³		1	1

注!

- [1]单端/差分 I/O 的数目包含 CLK 管脚、下载管脚。
- [2]这里的数目不包括 JTAGSEL_N, JTAGSEL_N 和 JTAG 管脚是互斥管脚, JTAGSEL_N 引脚和 JTAG 下载的 4 个引脚 (TCK、TDI、TDO、TMS) 不可同时复用为 I/O, 此表格的数据为 JTAG 下载的 4 个引脚复用为 I/O 时的情况。
- [3]引脚复用。

2.5 管脚定义说明

GW1NZ 列 FPGA 产品的管脚在不同的封装中对应不同的位置。

表 2-4 中对普通用户 I/O 的管脚定义、具有多功能的管脚定义、专用管脚的定義以及其他管脚定义进行了详细说明。

表 2-4 GW1NZ 列 FPGA 产品管脚定义说明

管脚名称	方向	说明
用户 I/O 管脚		
IO[End][Row/Column Number][A/B]	I/O	[End]提供管脚在器件中的位置信息, 包括 L(left) R(right) B(bottom) T(top) [Row/Column Number]提供管脚在器件中的具体行列位置信息, 若[End]为 T(top)或 B(bottom), 则提供列信息, 即管脚对应的 CFU 列数。若[End]为 L(left) 或 R(right), 则提供行信息, 即管脚对应的 CFU 行数[A/B]提供差分信号对信息
多功能管脚		
IO [End][Row/Column Number][A/B]/MMM		多功能管脚定义, /MMM 表示在用户 I/O 功能的基础上有另外一种或多种功能。当这些功能不使用的时

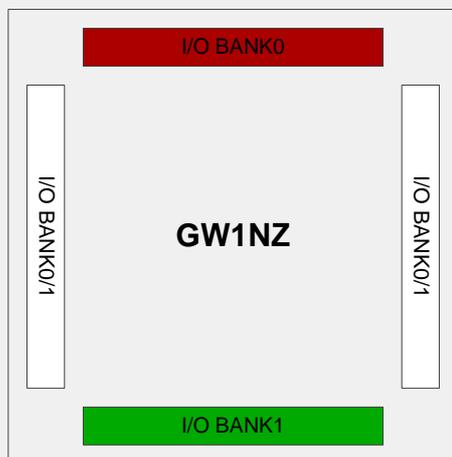
管脚名称	方向	说明
		候, 这些管脚可以用作用户 I/O
RECONFIG_N	I, 内部弱上拉	低电平脉冲开始新的 GowinCONFIG 配置
READY	I/O	高电平表示当前可以对器件进行编程配置 低电平表示无法对器件进行编程配置
DONE	I/O	高电平表示成功完成编程配置 低电平表示未完成编程配置或编程配置失败
FASTRD_N/D3	I/O	MSPI 模式下 Flash 访问速度选择端口 FASTRD_N, 低电平表示使用高速 Flash 访问模式, 高电平表示使用普通 Flash 访问模式 CPU 模式下的数据端口 D3
MCLK/D4	I/O	MSPI 模式下时钟输出 MCLK。 CPU 模式下的数据端口 D4
MCS_N/D5	I/O	MSPI 模式下的使能信号 MCS_N, 低电平有效 CPU 模式下的数据端口 D5
MI/D7	I/O	MSPI 模式下 MISO: Master 数据输入/Slave 数据输出 CPU 模式下的数据端口 D7
MO/D6	I/O	MSPI 模式下 MOSI: Master 数据输出/Slave 数据输入 CPU 模式下的数据端口 D6
SSPI_CS_N/D0	I/O	SSPI 模式下的使能信号 SSPI_CS_N, 低电平有效, 内部弱上拉 CPU 模式下的数据端口 D0
SO/D1	I/O	SSPI 模式下 MISO: Master 数据输入/Slave 数据输出 CPU 模式下的数据端口 D1
SI/D2	I/O	SSPI 模式下 MOSI: Master 数据输出/Slave 数据输入 CPU 模式下的数据端口 D2
TMS	I, 内部弱上拉	JTAG 模式串行模式输入
TCK	I	JTAG 模式串行时钟输入, 需要在 PCB 上连接 4.7K 下拉电阻
TDI	I, 内部弱上拉	JTAG 模式串行数据输入
TDO	O	JTAG 模式串行数据输出
SPMI_SDATA	I/O	SPMI (系统电源管理接口) 模式的通讯总线
SPMI_EN/VCCEN	I	SPMI (系统电源管理接口) 模式的睡眠控制和使能
SPMI_SCLK	I/O	SPMI (系统电源管理接口) 模式的通讯总线
SPMI_CLK	I	SPMI (系统电源管理接口) 外部低速时钟
JTAGSEL_N	I, 内部弱上拉	JTAG 模式选择信号, 低电平有效。
SCLK	I	SSPI, SERIAL, CPU 模式下的时钟输入
DIN	I, 内部弱上拉	SERIAL 模式下的数据输入
DOUT	O	SERIAL 模式下的数据输出
CLKHOLD_N	I, 内部弱上拉	高电平表示 SSPI 模式和 CPU 模式操作有效 低电平表示 SSPI 模式和 CPU 模式操作无效
WE_N	I	CPU 模式下选择 D[7: 0]的数据输入输出方向

管脚名称	方向	说明
GCLKT_[x]	I	全局时钟输入管脚, T(True) , [x]: 全局时钟序号
GCLKC_[x]	I	全局时钟输入管脚, C(Comp) , [x]: 全局时钟序号
LPLL_T_fb/RPLL_T_fb	I	左边/右边 PLL 反馈输入管脚, T(True)
LPLL_C_fb/RPLL_C_fb	I	左边/右边 PLL 反馈输入管脚, C(Comp)
LPLL_T_in/RPLL_T_in	I	左边/右边 PLL 时钟输入管脚, T(True)
LPLL_C_in/RPLL_C_in	I	左边/右边 PLL 时钟输入管脚, C(Comp)
MODE2	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG 配置模式选择信号端口
MODE1	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG 配置模式选择信号端口
MODE0	I, 内部弱上拉	GowinCONFIG 配置模式选择信号端口
其他管脚		
NC	NA	预留未使用
VSS	NA	Ground 管脚
VCC	NA	核电压供电管脚
VCCO#	NA	I/O BANK#的 I/O 电压供电管脚
VCCX	NA	辅助电压供电管脚

2.6 I/O BANK 说明

GW1NZ 系列 FPGA 产品分为四个 I/O BANK 区，图 2-1 为 GW1NZ 系列 FPGA 产品的 I/O BANK 整体示意图。

图 2-1 GW1NZ 系列 FPGA 产品 I/O BANK 整体示意图



封装与管脚手册列举了 GW1NZ 系列 FPGA 产品每种封装的管脚分布示意图。GW1NZ 系列 FPGA 产品的两个 BANK 用两种颜色区分。

用户 I/O、电源、地使用不同的符号和颜色来区分。GW1NZ 系列 FPGA 产品管脚示意图中管脚定义如下所示：

- “” 表示 BANK0 中的 I/O，填充颜色随 BANK 变化。
- “” 表示 BANK1 中的 I/O，填充颜色随 BANK 变化。
- “” 表示 VCC、VCCX、VCCO，填充颜色不变。
- “” 表示 VSS，填充颜色不变。
- “” 表示 NC。

3 管脚分布示意图

3.1 GW1NZ-1 器件管脚分布示意图

3.1.1 CS16 管脚分布示意图

图 3-1 GW1NZ-1 器件 CS16 封装管脚分布示意图（顶视图）

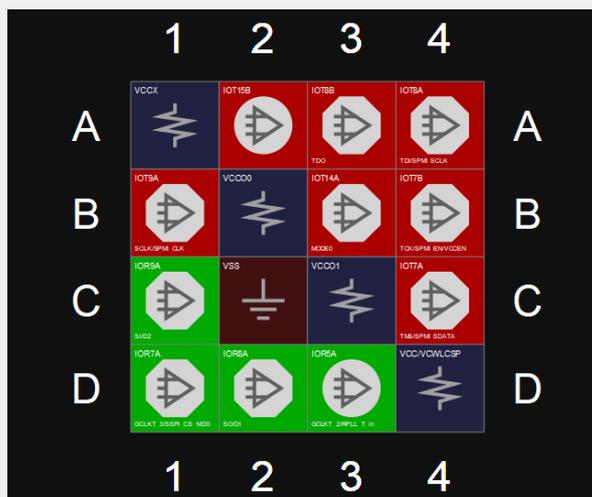


表 3-1 GW1NZ-1 器件 CS16 其他管脚

VCC00	B2
VCC01	C3
VCC/VCCM	D4
VCCX	A1
VSS	C2

3.1.2 FN32 管脚分布示意图

图 3-2 GW1NZ-1 器件 FN32 封装管脚分布示意图（顶视图）

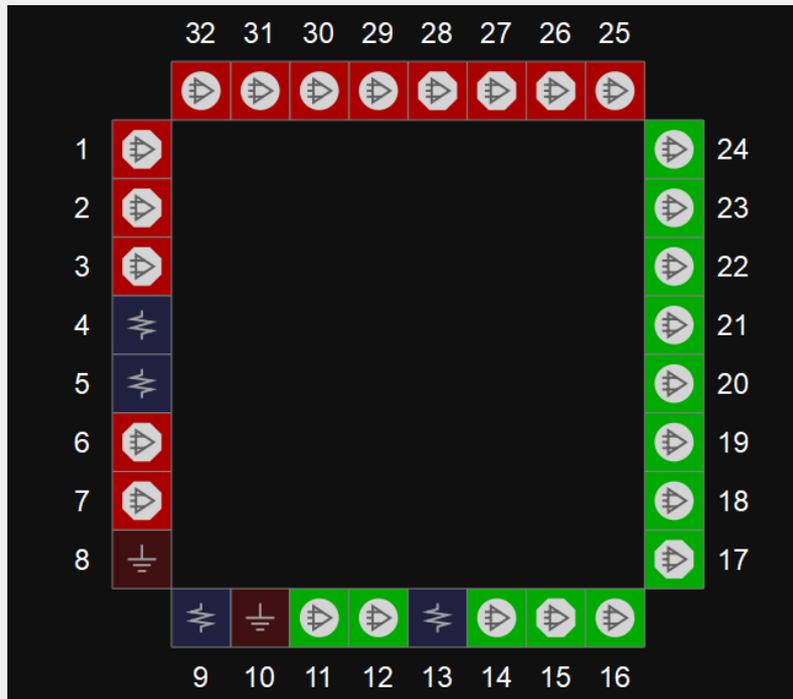


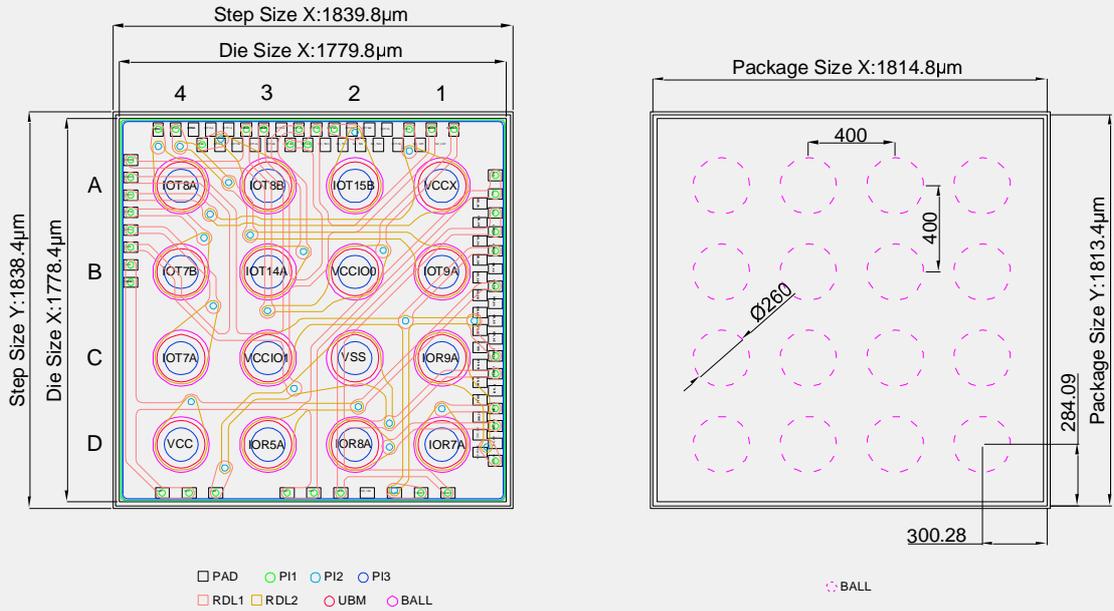
表 3-2 GW1NZ-1 器件 FN32 其他管脚

VCC00	5
VCC01	13
VCC/VCCM	9
VCCX	4
VSS	8、10

4 封装尺寸

4.1 封装尺寸 CS16 Package Outline (1.8mm x 1.8mm)

图 4-1 封装尺寸 CS16



TOP VIEW(BALL SIDE)

BOTTOM VIEW

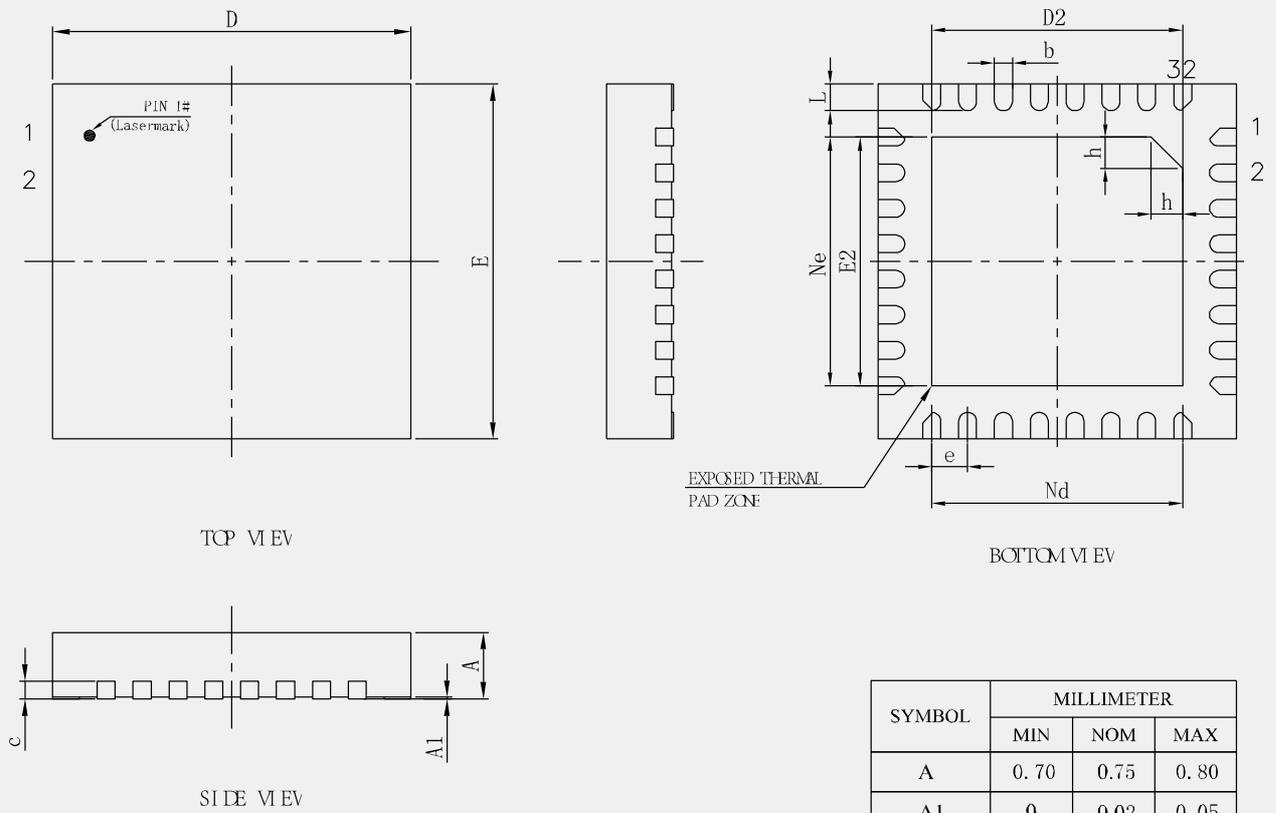


NOTCH DIRECTION

ITEM	DATA(UM)
PACKAGE SIZE X*Y	1814.8*1813.4±25
STEP SIZE X*Y	1839.8*1838.4
DIE SIZE X*Y	1779.8*1778.4
PAD OPENING SIZE	64.8*48.6
BALL DIAMETER	260±30
UBM DIAMETER	220
MIN BALL PITCH TO PACKAGE SIZE X AXIS	300.28
MIN BALL PITCH TO PACKAGE SIZE Y AXIS	284.09
BALL PITCH X/Y	400/400
BALL COUNT	16
DUMMY BALL COUNT	0

4.2 封装尺寸 FN32 Package Outline (4mm x 4mm)

图 4-2 封装尺寸 FN32



SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	0.70	0.75	0.80
A1	0	0.02	0.05
b	0.15	0.20	0.25
c	0.18	0.20	0.25
D	3.90	4.00	4.10
D2	2.70	2.80	2.90
e	0.40BSC		
Ne	2.80BSC		
Nd	2.80BSC		
E	3.90	4.00	4.10
E2	2.70	2.80	2.90
L	0.25	0.30	0.35
h	0.30	0.35	0.40
L/F载体尺寸	122X122		

